

证券代码：301319

证券简称：唯特偶



投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩沟通会（电话会） <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及人员名称	天风证券 文毓、朱晔；中银基金 时文博；招商基金 亢思汗；兴业基金 邹慧、刘文婷；太平养老保险 张凯；太平资产 邵军；华泰资产 朱荣华；银河基金 孙啸；融通基金 刘申奥；彤源投资 俞能飞；胤胜资产 李美泽；上海玖时私募基金 翁善根；运舟资本 廖书迪。
时间	2026 年 4 月 25 日上午
地点	上海市虹口区东大名路 678 号 4 楼会议室
上市公司接待人员姓名	副总裁兼董事会秘书：钟科先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司 2025 年应收增长及业绩变动的原因是什么？</p> <p>答：2025 年营收增长主要由微电子焊接材料业务驱动，该板块产品销量增长快速，同比增幅约 13.74%，收入 13.33 亿元、占比 88.61%。净利润下滑主因三点：一是上游锡金属等原材料价格波动，定价滞后导致毛利率同比下降 2.39 个百分点至 15.31%；二是战略投入加大，期间费用同比增加 2395.94 万元、增长 20.34%；三是公司理财收益及政府补助较上年同期均有所减少，合计同比下降 208.79 万元，降幅达 13.72%。</p> <p>本次利润波动为阶段性因素导致，公司主营业务经营稳健、</p>

长期发展基本面良好。后续公司将持续优化产品结构、严控成本费用、提升高端产品占比，稳步改善盈利水平。

2、公司主营业务及核心产品是什么？在行业内处于什么地位？

答：公司系国家级高新技术企业，深耕电子新材料领域，集研发、生产、销售于一体，核心聚焦电子装联材料，主营产品涵盖微电子焊接材料与微电子辅助焊接材料，核心产品为锡膏、锡条、锡线、助焊剂、清洗剂等。公司在国内微电子焊接材料领域居于领先地位，特别是在锡膏和助焊剂细分领域行业地位突出。公司依靠先进的技术实力、完备的生产工艺体系以及稳定的产品品质逐步占据行业优势地位。

3、请问公司核心技术壁垒与研发实力如何？

答：经过多年研发经验，公司已拥有 CNAS 认可实验室。截至 2025 年度末，公司累计主导及参与制修订国家标准 20 项、行业标准 12 项，拥有授权专利 36 项（其中发明专利 33 项）。依托扎实的科研基础，公司报告期内新增 6 项发明专利，并成功推出 5 号粉高可靠锡膏、7 号粉水溶性锡膏、低银高性能锡膏、水基助焊剂等多款新产品，产品兼具高性能、高可靠性与环保特性，充分体现了公司在技术研发领域的深厚积累与创新能力。

4、请问公司产品在光模块领域是否有运用？有哪些比较重要的客户？

答：在光模块及其部件的生产过程中，锡膏主要应用于三大环节：一是光器件（如 TOSA、ROSA）的 SMT 贴装，二是光芯片封装中的高精度倒装焊（如硅光芯片的微凸点焊接），三是 PCBA（印制电路板组件）上其他无源元件的表面贴装。公司的微电子焊接材料等产品可应用于上述应用场景。关于具体客户信息，基于保护客户商业秘密的原则，在符合信息披露监管要求的

前提下，公司不单独披露具体客户的业务数据。

5、公司今年的分红计划如何？未来能否继续维持高分红比例？

答：公司 2025 年度利润分配方案为：以现有总股本 124,520,951 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股（本事项尚需提交公司股东会审议）。公司自上市以来累计现金分红已超 1.9 亿元，年度分红总额占归母净利润的比例从 2022 年至 2024 年依次为 49.63%、80.36%和 76.12%。

公司未来将继续优化股东回报机制，以优异的经营业绩持续回馈投资者，与广大股东共享企业成长红利，实现公司与股东的可持续的共赢发展。有关内容请持续关注公司于巨潮资讯网披露的相关内容。

附件（如有）

日期

2026 年 4 月 25 日